



2026 年国际先进互连研讨会 (WAI 2026)

会议通知

各有关单位、业界同仁：

2026 年 IEEE 国际先进互连研讨会 (International Workshop on Advanced Interconnects, WAI 2026) 定于 2026 年 11 月 4 日至 6 日在杭州 Blossom Water Museum Hotel 举行。本届研讨会聚焦集成电路 (IC)、IC 封装、印制电路板 (PCB) 及高速线缆连接器等先进互连器件领域的信号完整性 (SI)、电源完整性 (PI) 与电磁干扰 (EMI) 最新进展与技术创新，为学术界与产业界搭建高水平交流平台。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间与地点

会议时间：2026 年 11 月 4 日—6 日（会期三天）

会议地点：杭州宝盛水博园大酒店（中国·杭州）

二、会议内容

大会包括主旨报告、分组技术报告、圆桌讨论及技术展览等环节，议题涵盖先进互连器件的信号完整性、电源完整性、电磁干扰等方向的最新研究成果、工程经验与产业趋势。

会议注册参会收费标准如下

注册类型	注册费（元）
学生全价票	1480
普通全价票	2480

本次会议期间，参会代表食宿费用自理。

本次会议注册费由宁波德图科技有限公司代为收取。

热忱欢迎各领域专家、学者及企业界人士莅临参会，共襄盛会！

宁波德图科技有限公司

谨代表 WAI 大会组委会

2026 年 10 月 8 日

